

台耀科技股份有限公司
提升企業價值計畫

[現況分析]

一、成本分析

(一)加權平均資金成本(WACC)計算：

1. 本公司資本結構係由 93%權益和 7%債務組成，公司的權益成本(Cost of Equity)為 13.24%，債務成本(Cost of Debts)為 1.45%，影響債務、權益融資成本的因素包括企業信用、經營風險等。透過加權平均資金成本(WACC)的分析使得本公司能評估資金使用效率、投資計畫的適切性和企業價值的合理性，本公司的加權平均資金成本(WACC)為 12.42%，較一般銅箔基板(CCL)產業平均之 11.19%稍高。這主要是因為我們採用的資金結構相較於同業平均有著較低的債務比率或相較同業股價波動較大等情況。本公司將進一步分析這些因素，以確保我們的資金成本是在合理的範圍內。

2. 總體經濟影響分析：利率、通膨率和匯率的波動均會對公司的 WACC 產生影響，這些因子的變化對於本公司相對可控，且本公司已制定有效的風險管理策略，透過利率交換、遠期外匯合約等工具進行避險，以降低這些因素對 WACC 波動的潛在風險。此外，本公司將定期進行總體經濟分析，以期在風險可控範圍內保持 WACC 的相對穩定性，有助於提高本公司對市場動態環境變化的應變能力，確保資金成本的合理性，進而維護企業的財務穩定。

二、獲利能力評估

ROIC 和 ROE 評估：公司的經營效能可透過投入資本報酬率(ROIC)和權益報酬率(ROE)進行評估。具體而言，本公司 ROIC 達到 22.18%，高於同業平均的 18.9%，顯示本公司在銅箔基板產業核心技術具一定優勢且客戶需求端穩定，實現較佳的資金使用效率。本公司 ROIC 高於 WACC，顯示我們整體上資本運用效率高。此外，本公司 ROE 達到 22.18%，亦高於同業平均的 18.72%表示公司有效地運用股東權益獲得良好的報酬。本公司的 ROIC 和 ROE 表現，顯示管理階層的有效資本配置，並展現公司在銅箔基板領域的競爭力及經營效能。

三、市場評價分析

(一)評價水準分析：本公司股價淨值比(PBR): 4.68 倍，高於同業平均之 4.23 倍，主要係因本公司在技術創新方面具有競爭優勢，並持續推出具有競爭力的產品，鞏固公司於同產業中的市場地位。終端需求亦在產業趨勢蓬勃發展下持續維持穩定發展，故評估市場給予本公司較高的股價淨值比為合理範圍。本公司將致力於確保投資人對公司的評價能反映出真實的內涵價值。

(二)潛在成長評估：由於 AI 產業持續高速發展下，各種大型語言模型日新月異，使整體訓練及推論算力需求高速擴張，而為使 AI 達到高速低延遲的效果，

也使交換器等網通產業出現世代性的發展，大型雲端服務業者資本支出持續攀升，國家級 AI 基礎建設計畫也陸續宣布創設，此均使超高速、超低耗損的高階材料需求快速成長，因此對以高階產品為定位的本公司，提供有利的發展環境。

本公司專注於 AI 伺服器、交換機及高速通訊及低軌衛星(LEO)產品應用，審慎樂觀看待高階銅箔基板材料 Hi-Speed Digital - Low Loss & Low CTE , Extreme Low Loss 224G, 112G 無鹵素材料, RCC 及高電壓厚銅特殊應用材料研究開發暨推廣服務。因此本公司除營業收入顯著成長外，產品組合也更進一步優化，帶動整體毛利率及獲利相較往年均大幅度成長，為公司提供了正向的市場機會。目前股價表現與此潛在成長動能相符，因此無需調整業務策略。

四、公司治理分析：

(一)董事會結構及獨立性：本公司董事會由七名董事組成，成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽；七位董事中，四位為獨立董事，其中包含一名女性獨立董事，佔全體董事席次的 57%。七席董事間二席董事互為二親等以內親屬；四席獨董與三席董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。本公司獨立董事皆具有豐富的產業實務經驗和專業知識：史欽泰獨立董事美國普林斯頓大學電機博士及美國史丹福大學管理科學碩士，曾為工業技術研究院院長、國立清華大學科技管理學院院長及財團法人資訊工業策進會董事長，具備超過 40 年半導體的產業經驗；陳正益獨立董事為 UMass-Lowell, USA 高分子博士，曾任泰國朱拉隆功大學材料系訪問教授，長期擔任銅箔基板相關產業研發副總經理；蘇怡仁獨立董事，美國麻省理工學院電機學士、美國康乃爾大學電機碩士及美國聖塔克拉羅大學法學博士具美國加州律師資格及專利及商標局律師資格，具法務專利專業職能與經驗；葉曙雯獨立董事國立台灣大學會計學系、美國聖荷西州立大學商學管理碩士，中華民國會計師，具財務會計專業職能與經驗。本公司透過董事會結構之多元化及獨立性，促使董事會決策過程充分考慮各種專業知識和觀點，並能獨立於公司管理階層，提供客觀的意見和建議。

(二)董事會運作之有效性：本公司每年對董事會和功能性委員會進行績效評估，另每三年進行外部績效評估，以提升其運作之有效性，評估內容包括對公司營運之參與程度、決策品質、成員之結構與選任、持續進修、內部控制等，以健全公司治理結構。

(三)資訊透明度：本公司定期舉行董事會，並於每次會後即時公開揭露董事會重要決議事項。此外，資訊透明度政策包括對重大決議事項的揭露和說明，以確保股東充分了解公司的營運和策略方向。另外，本公司網站在公司治理項下設置利害關係人及投資人專區，提供投資人本公司發言人之連絡窗口及信箱及法人說明會相關資料(中/英文版)，揭露各項資訊，以利股東充分了解公司的產品

服務、公司組織架構、財務資訊、股東資訊、營運及策略方向。本公司設置有發言人及代理發言人，負責對外公開財務業務相關資訊，股東得與公司進行溝通及建言，以維護應有之合法權益。

五、風險及競爭評估：

(一) 總體經濟分析：本公司營運所在地總體經濟、貨幣政策相對穩定健全，有利於企業的發展。本公司匯率之避險策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的，以與被避險項目公平價值變動呈高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並作定期評價。另針對通貨膨脹，主要以分散原料來源、以兩岸總需求量議定長期供貨約定。利率、通膨率和匯率仍維持在合理範圍內，有助於業務規劃和成本管理。全球經濟整體上，本公司受惠於全球 AI 產業持續高速發展下，各種 AI 及高速網通解決方案及大型雲端服務業者資本支出持續攀升，新世代解決方案材料等級的要求逐漸提高，因此對以高階產品為定位的本公司，提供有利的發展環境。在未來不確定因素方面，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，地緣政治持續惡化如俄烏戰爭，又加上美國總統川普(Donald J. Trump)上任以來，美中國際戰略衝突及與各國的貿易關稅戰將持續擴大，演變成全球貿易戰、極端天氣事件擾亂全球供應鏈、地緣政治風險升高等，這些因素都將影響貿易與投資表現，本公司將持續研判並加以關注。

(二) 產業競爭分析：本公司產業競爭優勢在於專注於高階銅箔基板，並受惠於 AI 伺服器及 800G 及 1.6T 交換器的需求成長，在技術、客戶與產能方面取得領先地位。技術能力是關鍵競爭力，本公司研發技術具備一定的水準並已建立長期穩定之供應鏈關係，持續的研發和創新使公司能夠提供高品質、高效能的產品，為滿足成長需求，本公司持續擴充產能以滿足市場對高頻高速材料技術不斷提升的需求。此外，公司擁有穩定而高效的供應鏈，確保生產和交付的順暢運作，有助於提高產品的競爭力和降低生產成本，使本公司在銅箔基板製造領域持續保持競爭力。

[政策與計畫]

一、短期強化計畫

短期而言，為提升資本使用效率，本公司將以強化客戶滿意度和堅持品質至上的企業價值觀為核心，進一步深化與現有客戶的夥伴合作，同時調整現有的產品和服務組合。透過提升營運效能、提高產能利用率，以及謀求合理的獲利水準，以期實現短期內的業務發展目標。同時，本公司將持續改善董事會的多元性和獨立性，透過定期評估董事會成員的表現和公司治理實踐情形，以增強董事會對管理層的監督能力。

二、中長期強化計畫

展望未來，本公司將持續投資於未來 5G & 6G 應用材料、新技術、新製程及更多環保無鹵(Halogen free)綠色產品與低碳 PCB 應用板材的開發，並秉持務實經營、提升自身研發能力、並強化與推展國內外終端客戶共同合作開發更具競爭

力及新應用領域之產品，導入智能製造系統，發揮生產技術及效益，提升高階高速高頻、低耗損板、高密度連結(HDI)板、射頻(RF)板、IC 載板基板等產品比重及 AI 伺服器、高階網通交換器、車用雷達及低軌衛星材料應用，其策略規劃如下：(1) 行銷策略如持續強化專業材料開發及技術服務核心能力、維持產品高品質、高效能形象、持續優化全球服務網路；(2) 優化全球製造鏈，除提升自動化生產，並逐步導入數位智慧製造以提升效率及降低成本；(3) 培養優秀研發人才，增強研發能力，推出創新功能之高附加價值新產品與技術服務；(4) 推動綠色研發和技術創新，加大在綠色技術和永續發展的研發投資，並在產品開發和製造過程中融入環保標準，符合全球節能減排趨勢。本公司將積極善盡企業責任，強化公司治理，提升各項產品核心技術競爭力，打造永續供應鏈，深化客戶互信與夥伴關係攜手成長，進而持續提升股東價值。

[溝通與追蹤]

一、與投資人積極溝通：

就相關揭露資訊建立相關機制，於公司網站、股東會、法說會等積極與投資人進行對話，包括說明公司之財務與公司治理分析結果及強化計畫之具體措施，以確保投資人對公司策略和計畫有全面的理解。

二、每年更新資訊：

每年至少進行一次進度說明，並更新揭露之資訊。